

2018年度

決算説明会資料

2019年5月16日



株式会社 メイコー
(証券コード：6787)

注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、その他、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。

1

2018年度 実績

2

2019年度 予想

3

今後の方針

2018年度 決算ハイライト

売上

- 売上は、前年比104億円増の1,189億円
 - ・車載は前年比13%増の547億円
 - ・スマートフォンは前年比横ばいの325億円
 - ・その他分野は前年比14%増の317億円

利益

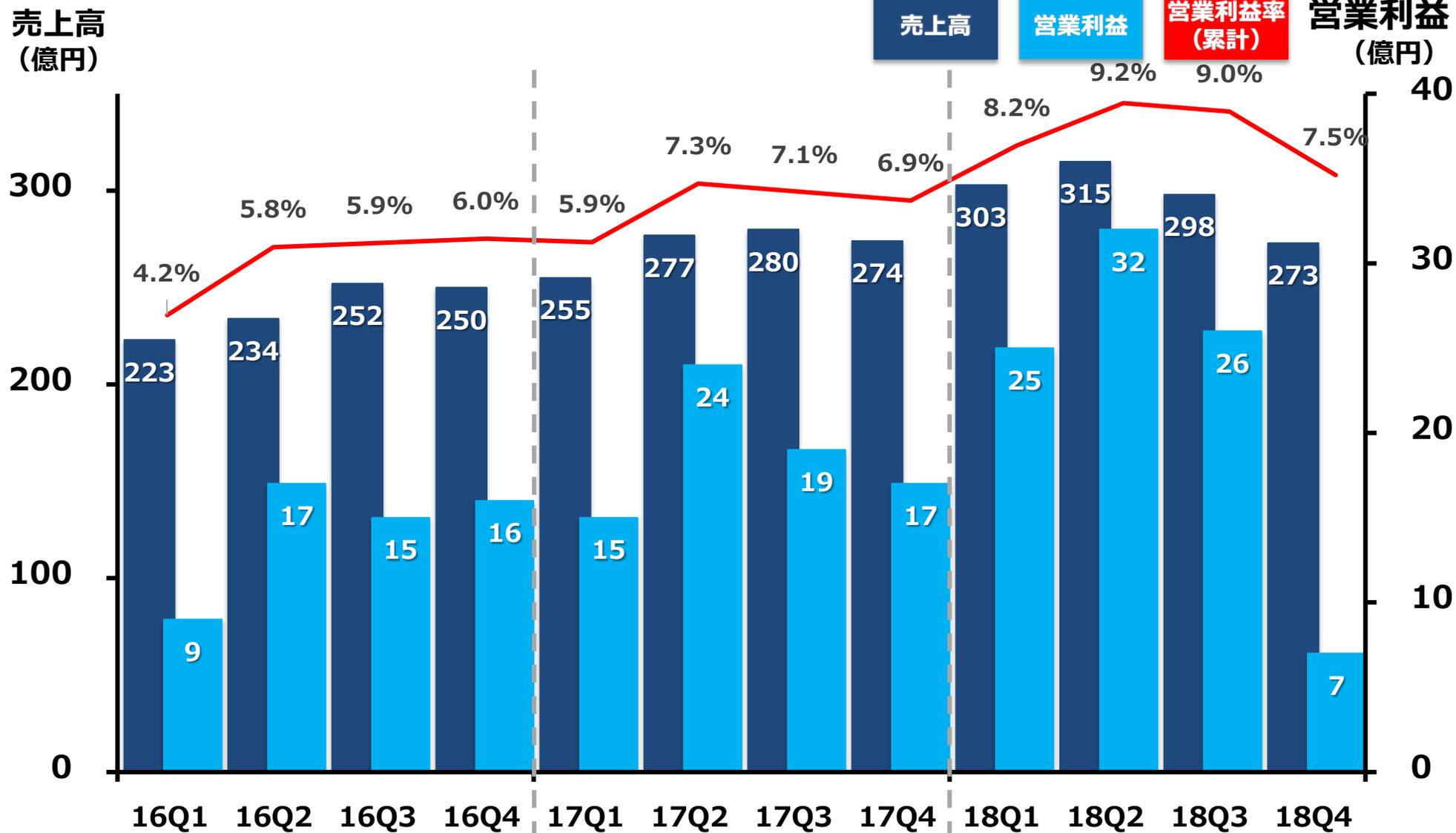
- 営業利益は、前年比15億円増の89億円
- 経常利益は、前年比38億円増の86億円
- 当期純利益は、前年比24億円増の67億円

2018年度 連結実績

(単位：億円)

	2017年度 実績	2018年度 実績	前年比	
			増減額	増減率
売上高	1,085	1,189	104	9.6%
営業利益	74 6.9%	89 7.5%	15	19.7%
経常利益	48 4.4%	86 7.2%	38	79.6%
当期純利益	43 4.0%	67 5.6%	24	54.2%
期中平均為替レート (円 / USD)	110.66	111.04		

売上高と営業利益推移



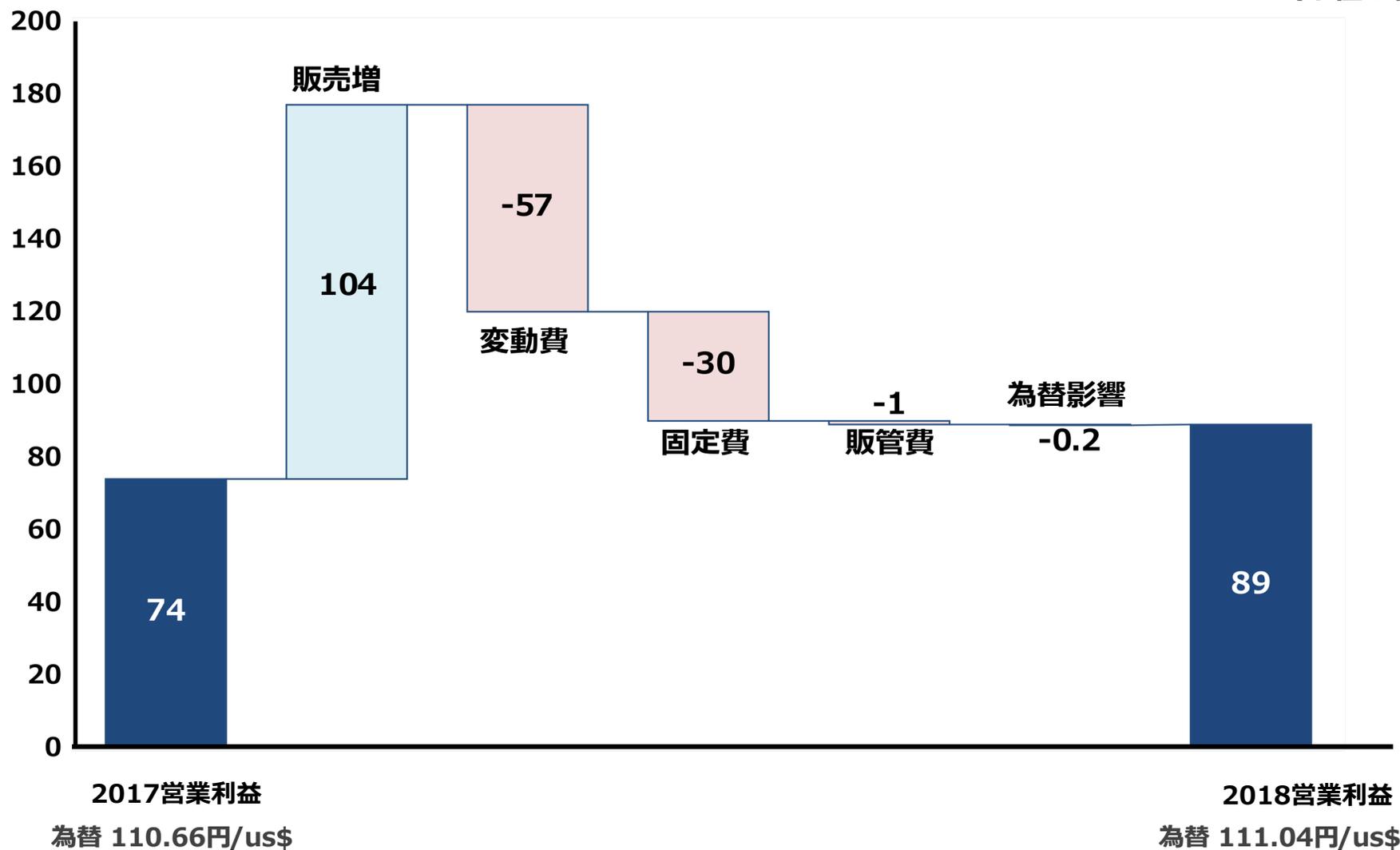
2018年度 製品別収益

(単位：億円)

	2017年度累計		2018年度累計		前年比	
	売上	営業利益 営業利益率	売上	営業利益 営業利益率	売上 伸び率	営業利益 伸び率
車載	483	37 7.7%	547	39 7.1%	64 13.3%	2 5.4%
スマートフォン	324	27 8.3%	325	38 11.7%	1 0.3%	11 40.7%
その他	278	10 3.6%	317	12 3.8%	39 14.0%	2 20.0%
合計	1,085	74 6.9%	1,189	89 7.5%	104 9.6%	15 19.7%

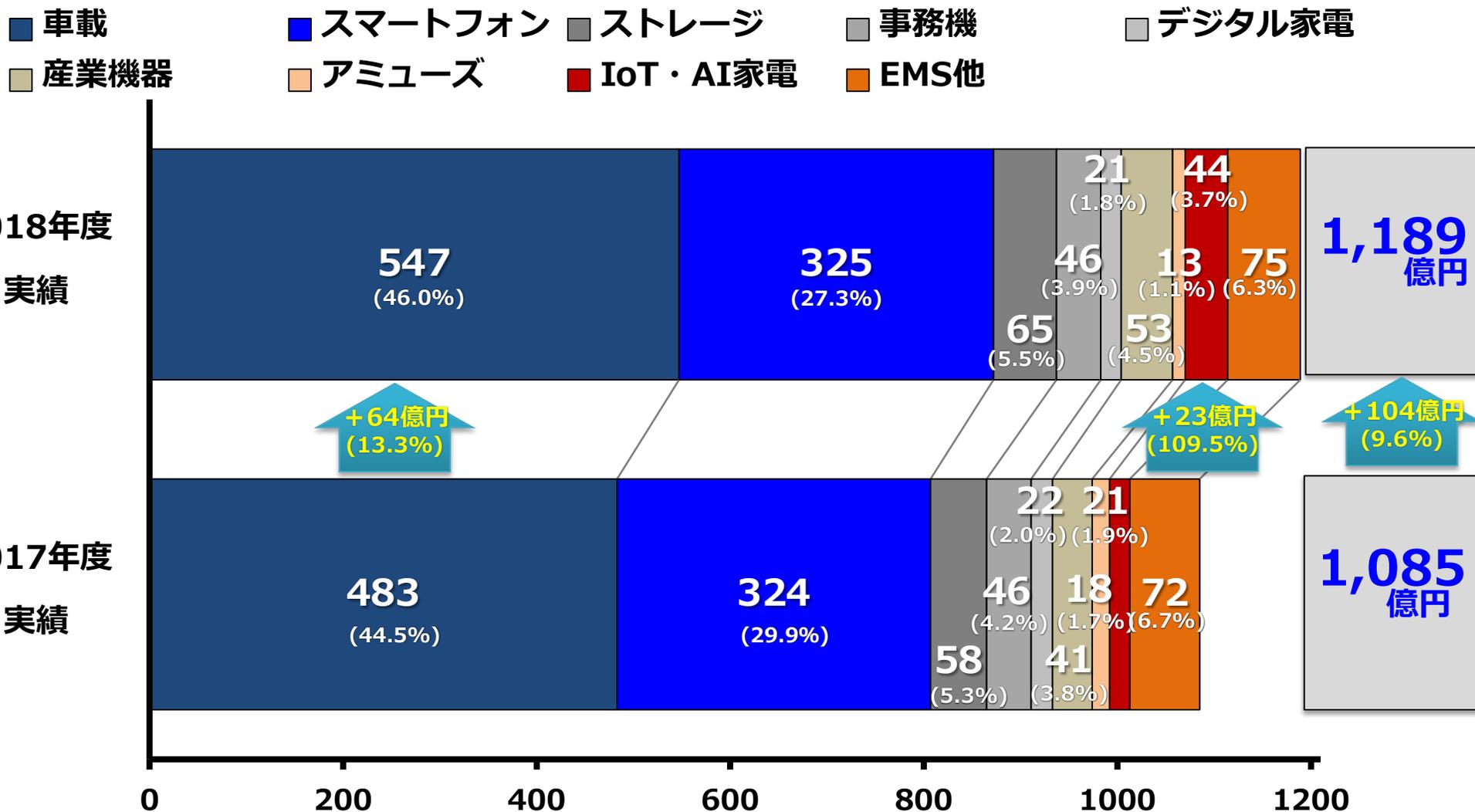
營業利益增減分析 ～ 2017年度→2018年度

(單位：億日元)



2018年度 商品別販売実績

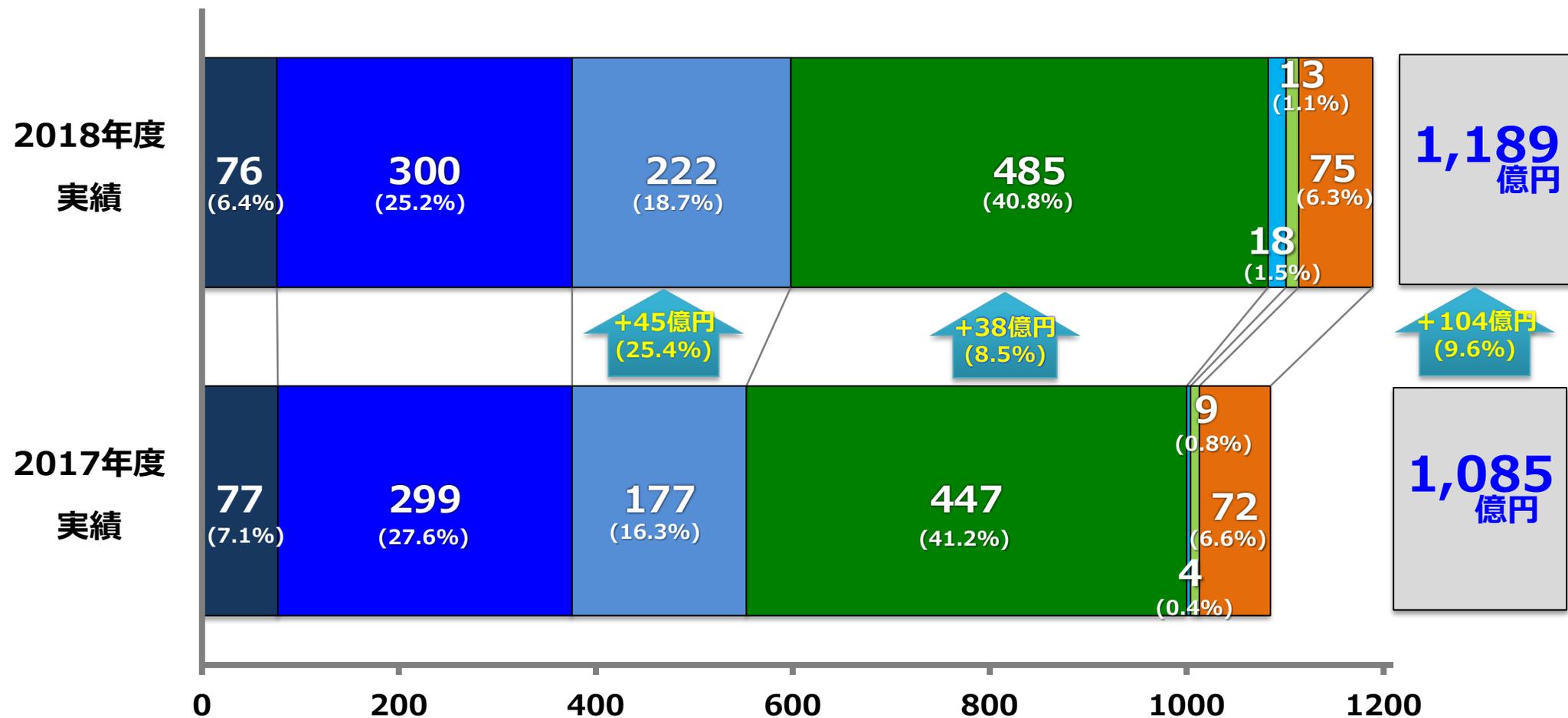
(単位：億円)



2018年度 仕様別販売実績

(単位：億円)

■ 両面板 ■ 4層板 ■ 6層板以上 ■ ビルドアップ ■ 放熱基板 ■ フレキ ■ EMS他



1

2018年度 実績

2

2019年度 予想

3

今後の方針

2019年度 展望

売上

前第4四半期の需要の落ち込みの影響を受けるが徐々に回復

- ・ 車載は需要の回復と新規案件の立上りで増加する見込み
- ・ スマホはビルドアップ基板をその他用途に振り向け減少の見込み
- ・ その他はIoT・AI家電、アミューズメント向けが増加する見込み

→通期としては2018年度から11億円増加して1,200億円

利益

- 営業利益は、前年比14億円減の75億円
- 経常利益は、前年比23億円減の63億円
- 当期純利益は、前年比14億円減の53億円

2019年度 連結業績予想

(単位：億円)

	2018年度 実績	2019年度 予想	前年比	
			増減額	増減率
売上高	1,189	1,200	11	0.9%
営業利益	89 7.5%	75 6.3%	-14	-16.0%
経常利益	86 7.2%	63 5.3%	-23	-26.8%
当期純利益	67 5.6%	53 4.4%	-14	-21.4%
期中平均為替レート (JPY / USD)	111.04	111.00		

2019年度 製品別収益予想

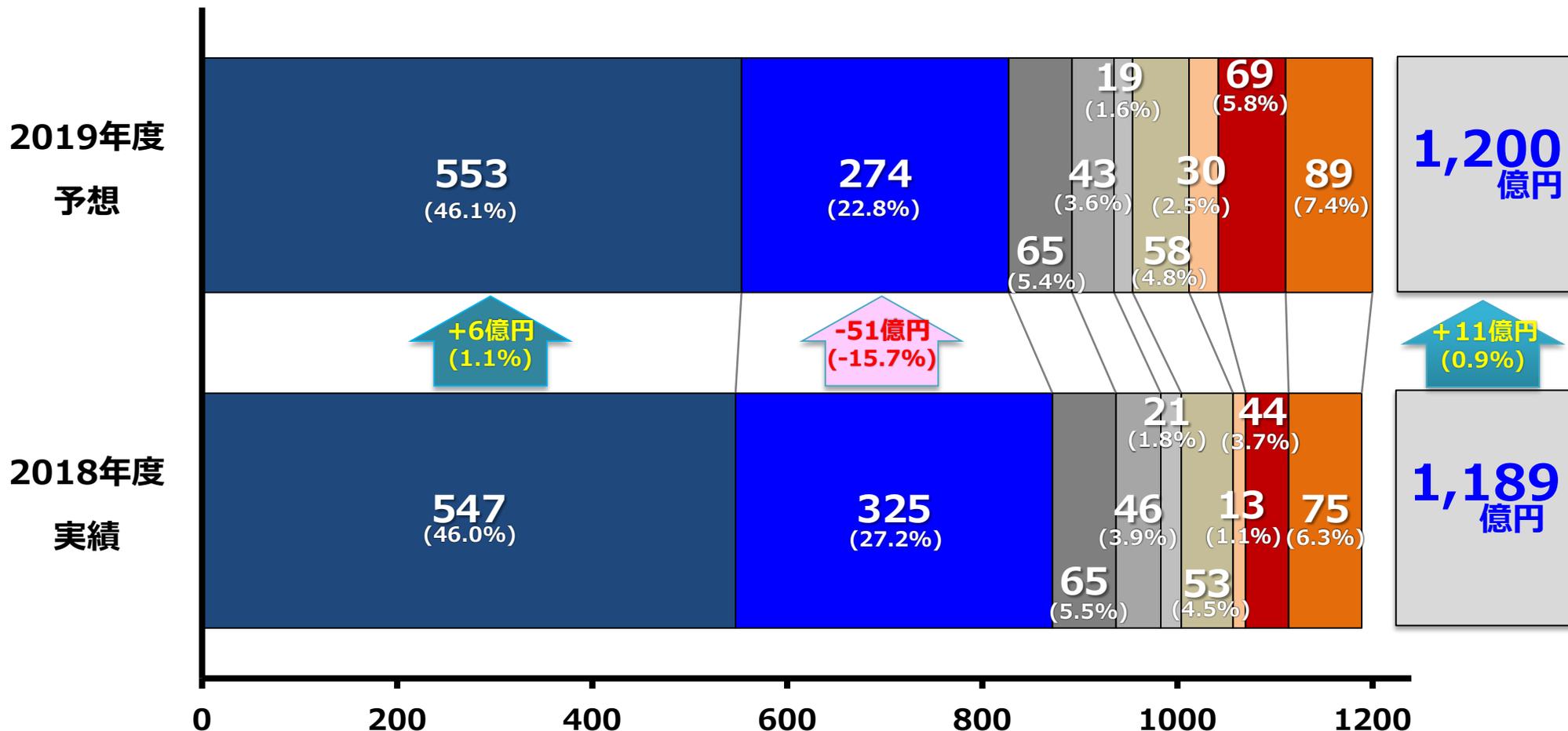
(単位：億円)

	2018年度累計		2019年度予想		前年比	
	売上	営業利益 営業利益率	売上	営業利益 営業利益率	売上 伸び率	営業利益 伸び率
車載	547	39 7.1%	553	40 7.2%	6 1.1%	1 2.6%
スマートフォン	325	38 11.7%	274	22 8.0%	-51 -15.7%	-16 -42.1%
その他	317	12 3.8%	373	13 3.5%	56 17.7%	1 8.3%
合計	1,189	89 7.5%	1,200	75 6.3%	11 0.9%	-14 -16.0%

2019年度 商品別販売予想

(単位：億円)

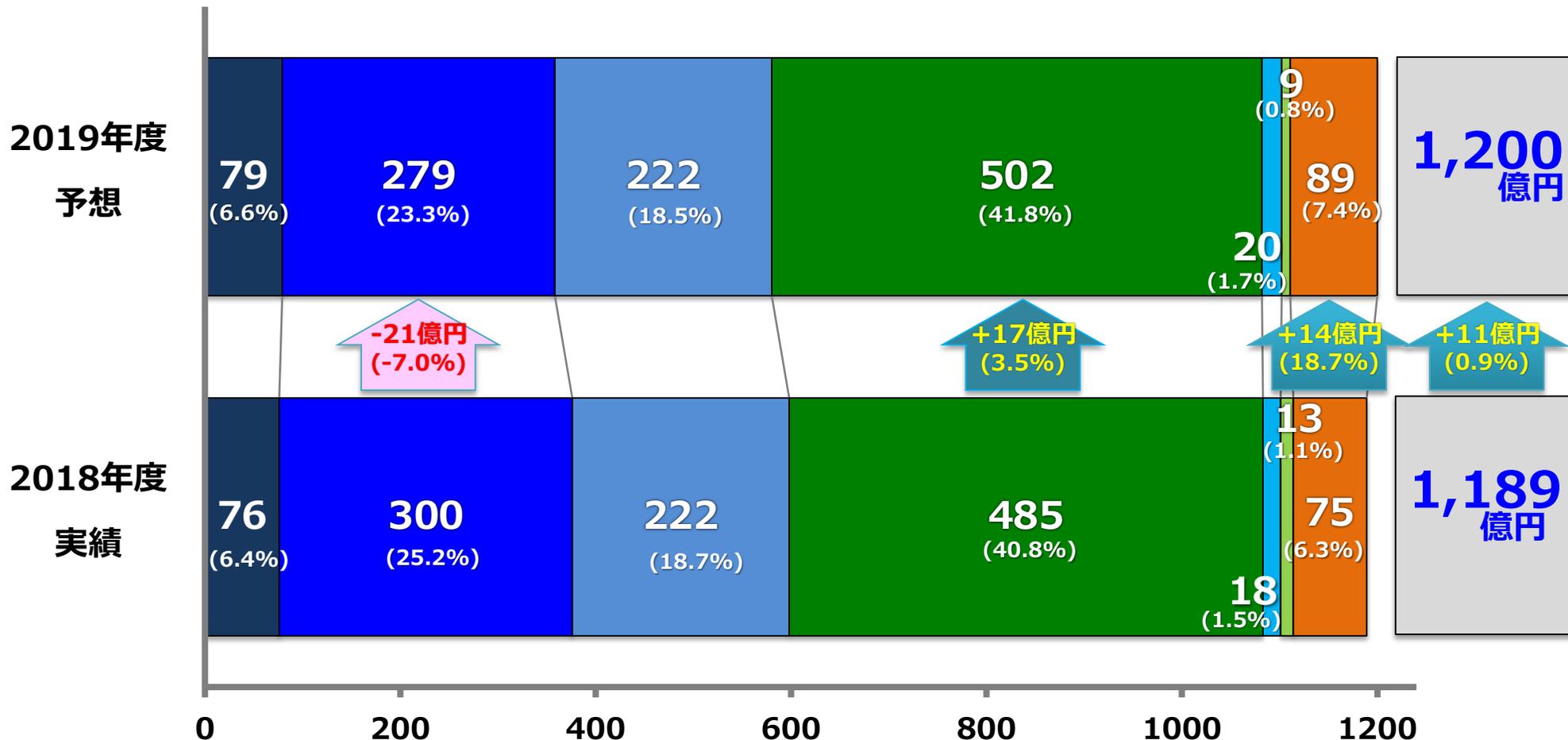
- 車載
- スマートフォン
- ストレージ
- 事務機
- デジタル家電
- 産業機器
- アミューズ
- IoT・AI家電
- EMS他



2019仕様別販売予想

(単位：億円)

■ 両面板 ■ 4層板 ■ 6層板以上 ■ ビルドアップ ■ 放熱基板 ■ フレキ等 ■ EMS他



1

2018年度 実績

2

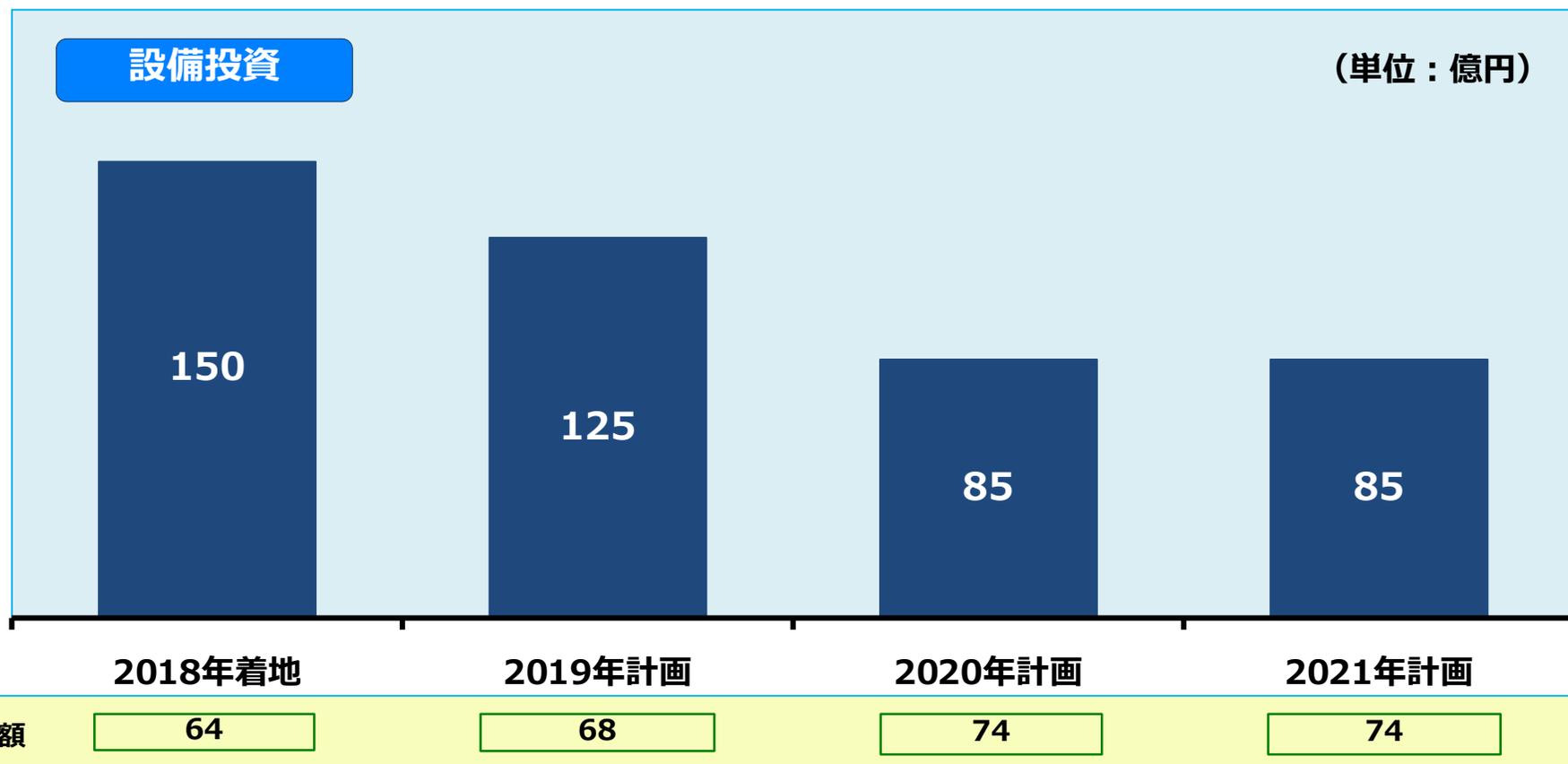
2019年度 予想

3

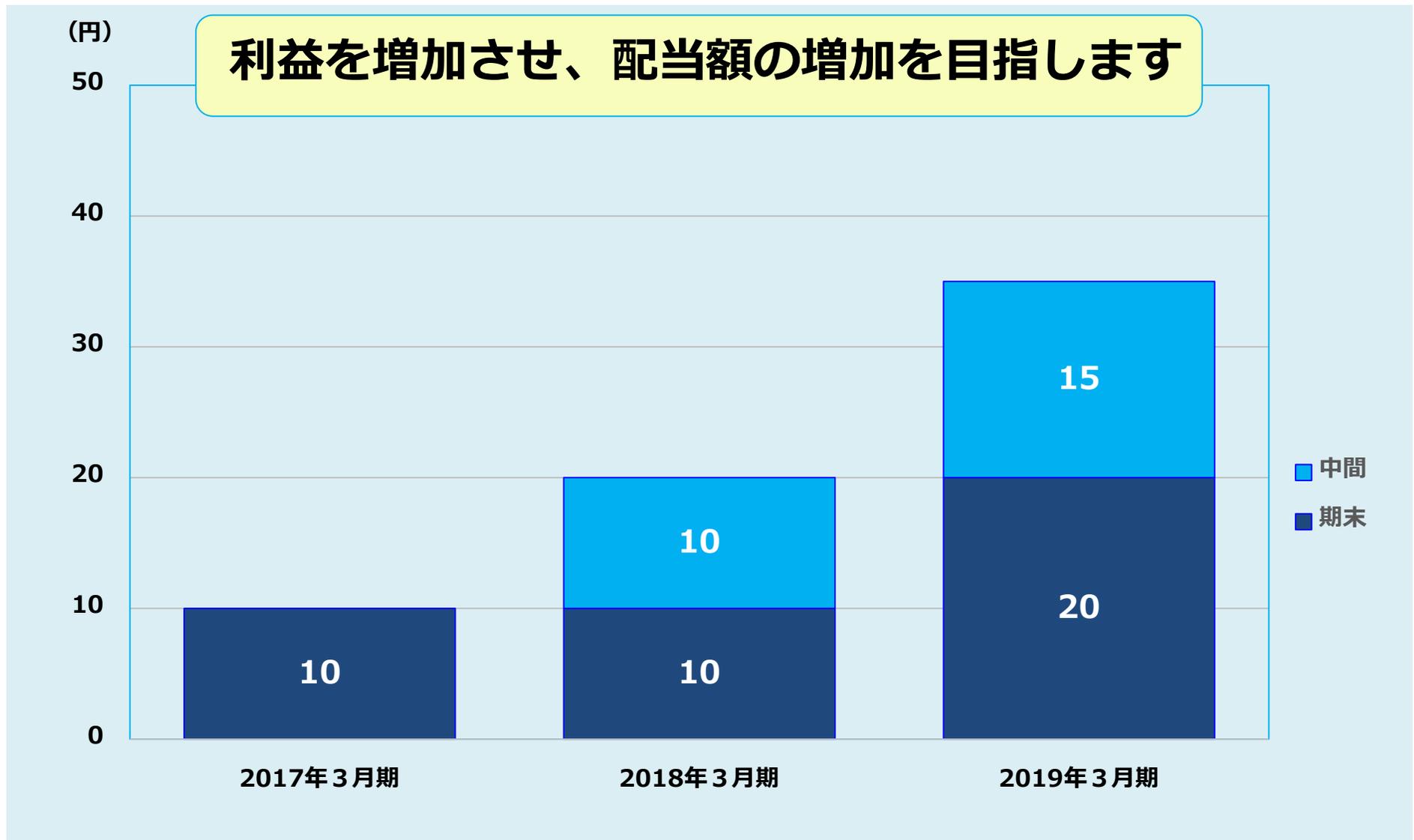
今後の方針

財務体質の強化をしながら規模の拡大を図る

- ・ 投資抑制を通じて有利子負債の圧縮を図る
- ・ その結果、自己資本比率、売上高有利子負債比率を改善する
- ・ ベトナム新工場の完成により、3か年で生産規模の倍増を図る



配当の推移



MSAP事業方針

スマートフォン市場は、新たな通信基盤である「5G」により、プリント基板への要求仕様が変化していく

2019年は「5G」元年

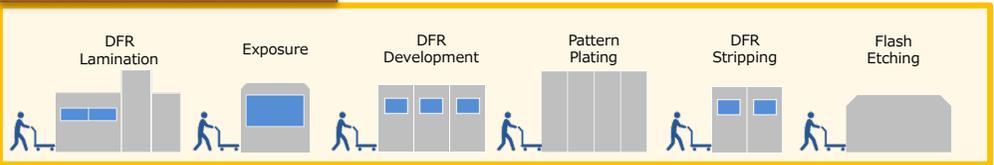


超高速 大容量	高精細画像 AR/VRトレーニング
超低遅延	自動運転 リアルタイム翻訳
多数 同時接続	スマートシティー 遠隔操作

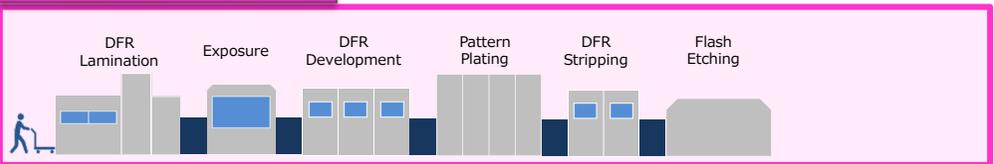
スマートフォン市場のPCB要求は高精細化が加速



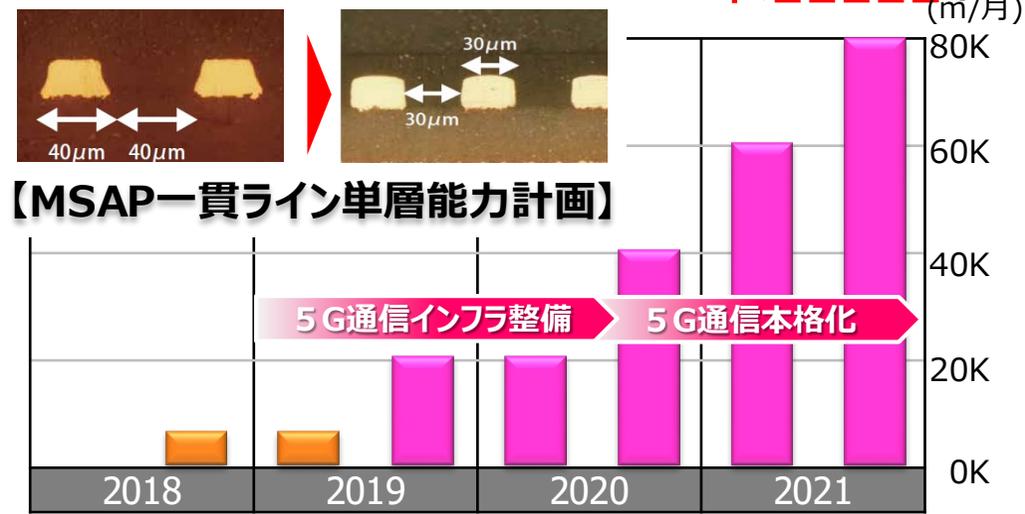
従来のMSAP生産方法



MSAP一貫生産ライン



従来のサブトラとの混流生産からMSAP一貫生産ラインを立ち上げ、歩留りや生産性を大幅に改善



FPC事業方針

今後のFPC市場は、車載での使用が多く見込まれ、当社の強みを活かすことが可能。
また通信の分野でも高速通信対応の製品など多様な商品への対応を加速。

FPC基板



ポディー（照明）	スマートフォン
インフォテインメント	ストレージデバイス
走行安全系	通信インフラ等

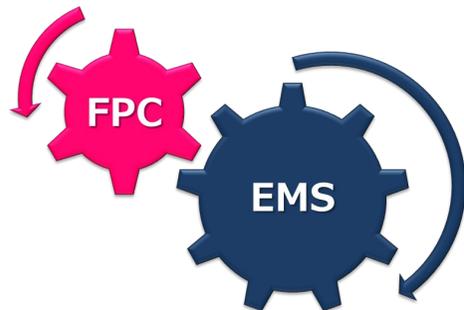


注力する市場製品と量産化ポイント

車載 = 高耐熱・低膨張材に対するモノづくり
通信 = 5Gに牽引された低伝送損失FPCや
多層FPCの量産化技術確立



次世代製品への挑戦とEMS事業とのシナジー効果創出

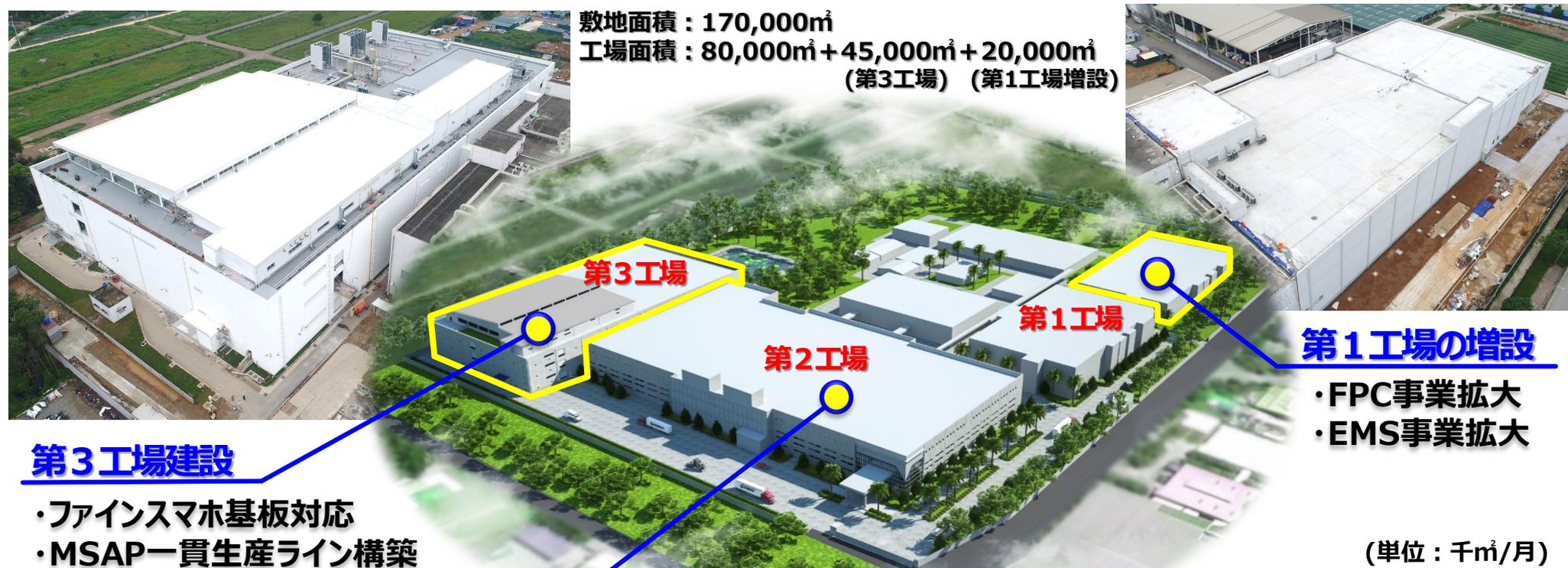


ベトナム工場は、FPC基板製造と部品実装・組立工場が隣接しており、一貫生産が可能となる。
モノづくりにおいても相互情報よりスピーディな対応が図れる。



ベトナム工場方針

敷地面積 : 170,000㎡
 工場面積 : 80,000㎡ + 45,000㎡ + 20,000㎡
 (第3工場) (第1工場増設)



第3工場建設

- ・ファインスマホ基板対応
- ・MSAP一貫生産ライン構築
- ・車載開発品対応スペース

既存第2工場

- ・車載製品の増産対応
- ・車載ビルドアップ専用ライン構築

第1工場の増設

- ・FPC事業拡大
- ・EMS事業拡大

(単位 : 千㎡/月)

生産能力拡大計画		2018	2019	2020	2021
第1工場	FPC (EMS)	20 (12)	25 (16)	35 (22)	45 (28)
第2工場	車載貫通板 車載ビルドアップ°	40 (5)	80 (10)	120 (20)	150 (30)
第3工場	スマホビルドアップ° (MSAP) 車載開発品	70 - -	75 (20) -	80 (40) 5	85 (80) 10

新工場は2019年7月より順次量産開始